親愛的產業先進 您好：

首先，我們要由衷地感謝貴公司長期以來對International VLSI Symposium on Technology, Systems and Applications（簡稱：VLSI TSA）的大力支持，讓我們的研討會得以持續發展，提供更廣泛的技術內容，以滿足產學界和學術界的需求。

2024 VLSI TSA研討會將於4月22日至25日假新竹國賓飯店舉行。我們已邀請優秀的演講嘉賓，其中包括美國IBM的副總裁Dr. Huming Bu，他將分享關於“2nm技術”的相關技術。此外，我們還邀請到美國耶魯大學的Priya Panda，將探討“能源高效邊緣智能的神經形態計算”；德國TU Dresden and NaMLab gGmbH的Dr. Thomas Mikolajick，將探討“鐵電材料對半導體設備的增強影響”；日本SONY的Yoshihisa Kagawa，將討論“先進CMOS圖像傳感器的3D堆疊技術”；以及日本NTT的Dr. Yosuke Aragane，他將分享“光子技術促進下一代可持續ICT基礎設施”的主題演講。此外，Alice Chang，Perfect Co.的創始人和首席執行長，將在午餐時間演講中分享“美容和時尚技術中的生成AI革命”等內容。此外，我們還舉辦兩場聯合特別會議，分別討論Energy-efficient Computing和Power Devices and Electronics，並邀請了國際知名的專家學者參與，共同探討相關技術的發展現況、應用和挑戰。同時，我們還為大會精心設計了三個深度短期課程，領域涵蓋:

- Emerging High-performance. Energy-efficient CMOS Materials and Devices

- Advanced Interconnect and Packaging Technologies and Design

- Test of Data-intensive Computing Accelerators

VLSI TSA研討會將提供一個豐富多彩的學習和交流平台，包括一百多場專題演講和高質量的論文發表，除上所提及主題外，研討會更安排多場主題演講，內容廣泛多元，包括：Quantum Computing with Silicon Spins、Novel Quantum Computing Devices and Materials、High Performance, Ultralow Power CMOS Materials and Devices、Advanced Memory Technology、Emerging Technologies for High-performance Computing、ChatGPT for mobile device及Wideband-gap material transfer using Smart CutTM Technology for Power Electronics 等引人注目的題目，我們幸運地邀請到該領域的專家學者前來演講，為本次研討會增色不少。

本研討會由工業技術研究院主辦，歷年來經費多仰賴業界廠商的贊助，使大會得以圓滿成功，懇請 貴公司能繼續給予支持及贊助。如蒙贊助，大會將不勝感激，必當全力以赴，同時歡迎 貴公司先進蒞臨指導、共襄盛舉。

⦁ 相關研討會資訊，敬請參考大會網站: <https://expo.itri.org.tw/2024VLSITSA>

⦁ 12024 VLSI TSA研討會議初步程表，請參閱附件一，謝謝！

本屆大會之贊助廠商，將享有以下優惠之服務，以茲銘謝：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贊 助 方 案** | | | |
| **贊助額(台幣)** | **3萬元** | **5萬元** | **10萬元** |
| 1名免費名額 | ● |  |  |
| 3名免費名額  (原註冊費用為71,700) |  | ● |  |
| 10名免費名額  (原註冊費用為239,000) |  |  | ● |
| 每增加1萬，則增1名免費名額 |  | ● | ● |
| 會場放置贊助廠商簡介 | ● | ● | ● |
| 大會形象牆 展示贊助廠商企業標誌 |  | ● | ● |
| 會場播放贊助廠商形象影片 |  | ● | ● |
| 主管列名大會顧問委員會 |  |  | ● |
| 大會議程手冊 標印贊助廠商企業標誌 | ● | ● | ● |
| 大會網站超連結至贊助廠商網站 |  | ● | ● |
| 大會議程手冊刊登半頁贊助廠商資訊 |  |  | ● |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024國際超大型積體電路技術、系統暨應用研討會 敬謝**  大會主席 張世杰所長  工業技術研究院 電子與光電系統研究所   |  | | --- | | **贊助同意書**  **贊助金額：新台幣　 　　 　　萬元整** | |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企業團體 全銜 |  | | |
| 統一編號 |  | | |
| 列名顧問委員會主管姓名/職稱  (10萬以上) |  | | |
| 贊 助 聯 絡 人 | | | |
| 姓 名 |  | 電 話 |  |
| Email |  | | |
| 聯絡地址 |  | | |
| 研 討 會 報 名 聯 絡 人 | | | |
| 姓 名 |  | 電 話 |  |
| Email |  | | |

如蒙贊助，請回覆贊助函，大會將於2024年1月上旬檢附收據，洽請 貴公司撥款。

**研討會贊助款撥款方式：電匯／即期支票**

抬頭：工業技術研究院（統編：02750963）

電匯銀行：戶名：財團法人工業技術研究院

土地銀行工研院分行，帳號：156005000025（電匯請務必傳真收執聯03-5820029）

郵寄地址：31057新竹縣竹東鎮中興路四段195號51館1030-1室

**秘書處聯絡人：**郭玉敏 03-591-5577 [ymkuo@itri.org.tw](mailto:ymkuo@itri.org.tw)

邱秀雲 03-591-4778 [harrietchiu@itri.org.tw](mailto:harrietchiu@itri.org.tw)

徐歆伃 03-591-5287 [cindyhsu0119@itri.org.tw](mailto:cindyhsu0119@itri.org.tw)